



半导体行业深度报告：全球缺芯潮带来的国产替代机会



?全球缺芯潮带来的半导体国产替代机会今年以来，全球各制造领域尤其是汽车行业遭遇的半导体器件短缺成为了市场关注的焦点。此次广泛的半导体供给不足是需求端、供给端以及突发事件等多种因素综合导致的结果，持续时间及影响范围超出市场预期，为国产半导体行业的发展带来了机遇。

?半导体设备领域：2020 年以来，半导体设备制造商销售回暖趋势明显，全球几大核心晶圆制造厂商均抛出超越市场预期的资本开支计划。虽然此后受到新冠疫情全球性扩散的冲击，但从产品销售规模的增长趋势来看，上游市场对于半导体设备的整体需求并未减弱。此外，国内晶圆制造产业迎来快速扩张期，将给上游设备市场带来成长机遇。目前国内半导体设备国产化率普遍较低，全球半导体设备市场依然由美国主导，装备环节在中美贸易摩擦的环境中极容易成为遏制国内产业链正常运转的关键性一环。在大基金二期的有力推动以及外部环境催化的共同作用下，半导体设备领域的重要性将进一步凸显。

?半导体硅片领域：硅片行业周期与半导体行业周期基本同步，5G 手机，数据中心以及汽车电子等将成为硅片行业未来需求增长的核心驱动力。行业整体竞争格局表现为市场集中度高、进口依赖度高。中国大陆半导体硅片销售规模增长快于全球平均，从供需格局来看，供给缺口目前仍然存在。2021 年全球新增晶圆产能有望创下历史新高，大陆半导体晶圆产能扩张趋势延续，大量新建晶圆制造产能将按规划落地，未来国产硅片的替代

趋势值得关注。

?半导体封测领域：6月，中国台湾半导体封测大厂京元电子竹南厂发生聚集性感染事件。此后，随着感染人数的增多，相关部门要求该公司的外籍移工自7日起全面停工14天，京元电预估6月产量减少30%至35%。相对其他产业链环节，大陆半导体行业在封测领域具有较强的市场竞争力。考虑到台厂停工、东南亚封锁等因素影响当地半导体封测产能，将可能导致部分订单转向大陆企业，封测端企业尤其是龙头上市公司的后续业绩有望受益。

?功率半导体领域：新能源汽车拉动IGBT用量，国产缺口亟待填补。IGBT是新能源汽车中最为核心的部件之一，应用于电控系统、车载空调控制系统、充电桩等多个方面，同时具备较高的价值占比。随着新能源汽车制造等领域的快速增长，国内IGBT市场规模已达到全球市场的45%以上，而对应的国产产能还存在巨大的缺口。近年来，国内功率器件厂商积极布局IGBT领域，未来拥有较大的国产替代空间。

?风险提示：1、宏观经济波动风险；2、下游市场需求不及预期风险；

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_33408

